

ELMOS Semiconductor AG
Dortmund

Jahresabschluss und Lagebericht
31. Dezember 2004

- Zur Einreichung zum Handelsregister -

BESCHEINIGUNG

Der zur Offenlegung bestimmte Jahresabschluss und der Lagebericht entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Zu dem Jahresabschluss und Lagebericht haben wir den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2004 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Dortmund, 11. Februar 2005

Ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Brorhilker
Wirtschaftsprüfer

gez. Muzzu
Wirtschaftsprüfer

AKTIVA			PASSIVA				
	EUR	EUR	31.12.2003 TEUR		EUR	EUR	31.12.2003 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	19.300.000,00		19.300
1. Software und Lizenzen	12.873.829,33		7.427	II. Kapitalrücklage	84.000.000,00		84.000
2. Geleistete Anzahlungen	4.218.137,89		7.215	III. Gewinnrücklagen			
	<u>17.091.967,22</u>		<u>14.642</u>	Andere Gewinnrücklagen	102.223,64		102
II. Sachanlagen				IV. Bilanzgewinn	<u>40.461.865,71</u>		<u>28.572</u>
1. Grundstücke und Bauten	10.048.956,56		8.743			143.864.089,35	131.974
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.288.225,81		12.744	B. RÜCKSTELLUNGEN			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.170.663,36		1.350	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.704.231,00		1.193
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.462.085,83		3.266	2. Steuerrückstellungen	3.767.671,95		2.053
	<u>37.969.931,56</u>		<u>26.103</u>	3. Sonstige Rückstellungen	<u>4.329.796,07</u>		<u>3.438</u>
III. Finanzanlagen						9.801.699,02	6.684
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	61.593.706,59		32.348	C. VERBINDLICHKEITEN			
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		164	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.245.081,77		12.714
3. Beteiligungen	247.348,77		326	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	135.361,20		28
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	992.131,21		1.009	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.030.428,12		5.504
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	724.344,00		724	4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	2.500.000,00		5.100
6. Sonstige Ausleihungen	0,00		92	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.631.849,91		4.088
	<u>63.557.530,57</u>		<u>34.663</u>	6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10.286,58		2
		118.619.429,35	75.408	7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.251.781,18</u>		<u>2.127</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN						31.804.788,76	29.563
I. Vorräte				D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		4.410,00	0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.447.732,45		4.709				
2. Unfertige Erzeugnisse	9.865.550,00		10.442				
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	4.633.541,79		2.887				
	<u>19.946.824,24</u>		<u>18.038</u>				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.668.712,67		16.668				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.648.443,90		35.810				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	348,00		16				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.985.721,33		4.111				
	<u>32.303.225,90</u>		<u>56.605</u>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>12.596.556,20</u>		<u>15.246</u>				
		64.846.606,34	89.889				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>2.008.951,44</u>	<u>2.924</u>				
		<u>185.474.987,13</u>	<u>168.221</u>				
						<u>185.474.987,13</u>	<u>168.221</u>

ELMOS Semiconductor AG, Dortmund
Gewinn- und Verlustrechnung für 2004

Anlage 2

	EUR	2003 TEUR
1. Umsatzerlöse	127.143.231,90	102.980
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+1.170.671,27	-1.366
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	913.097,08	987
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>7.499.265,73</u>	<u>9.657</u>
	136.726.265,98	112.258
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	-14.296.154,75	-11.199
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26.835.990,06	-19.546
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-23.441.070,58	-22.118
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 511.430,64 (Vj. TEUR 88)	-4.740.297,51	-3.960
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-6.894.521,29	-9.550
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-37.155.601,90</u>	<u>-32.883</u>
	<u>-113.363.636,09</u>	<u>-99.256</u>
	23.362.629,89	13.002
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 655.918,79 (Vj. TEUR 225)	655.918,79	1.213
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.944.906,58	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 684.549,73 (Vj. TEUR 1.185)	1.280.109,97	1.371
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	-401
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 71.304,17 (Vj. TEUR 89)	<u>-5.576.005,55</u>	<u>-1.338</u>
	<u>304.929,79</u>	<u>845</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.667.559,68	13.847
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.945.055,15	-5.562
16. Sonstige Steuern	<u>-323.121,08</u>	<u>-175</u>
	<u>-9.268.176,23</u>	<u>-5.737</u>
17. Jahresüberschuss	14.399.383,45	8.110
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>26.062.482,26</u>	<u>20.462</u>
19. Bilanzgewinn	<u><u>40.461.865,71</u></u>	<u><u>28.572</u></u>

ELMOS Semiconductor AG, Dortmund

Anhang 2004

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Änderungen ergaben sich im Fall der Abschreibungen auf Sachanlagen. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern für die technische Anlagen im Backend-Bereich (Tester) und Mietereinbauten wurden aufgrund betrieblicher Erhebungen erhöht. Hieraus ergab sich eine positive Ergebnisauswirkung von TEUR 674 vor Steuern.

Erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (3 – 5 Jahre, lineare Methode) vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbsterstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten einbezogen. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Soweit steuerlich zulässig, wird für bewegliche Anlagegüter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Der Übergang zur linearen Methode erfolgt in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Bei den **Finanzanlagen** werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Die **unfertigen und fertigen Erzeugnisse** sind auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen entsprechend dem steuerrechtlichen Mindestumfang berücksichtigt werden. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Verkaufspreisen Abschläge für noch anfallende Kosten vorgenommen.

Alle erkennbaren Risiken im **Vorratsvermögen**, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die **Rückstellungen für Pensionen und Vorruhestandsverpflichtungen** werden in steuerlich zulässiger Höhe ausgewiesen. Den nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwerten gemäß § 6a EStG liegt unter Verwendung der Sterbetafeln 1998 ein Rechnungszinsfuß von 6 Prozent zugrunde.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zuschüsse auf Entwicklungsleistungen werden als Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Fremdwährungen wurden zu Umrechnungskursen am Tage ihrer Entstehung oder zu niedrigeren bzw. höheren Stichtagskursen bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte		
	1.1.2004 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2004 EUR	1.1.2004 EUR	Zugänge EUR	Zuschreibung wg. steuerlicher Außenprüfung EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31.12.2004 EUR	31.12.2004 EUR	31.12.2003 TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Software und Lizenzen	13.270.752,45	2.629.867,45	4.597.821,38	2.854,00	20.495.587,28	5.844.087,68	1.778.780,16	0,00	0,00	1.109,89	7.621.757,95	12.873.829,33	7.427
2. Geleistete Anzahlungen	7.215.230,19	1.200.729,08	-4.197.821,38	0,00	4.218.137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218.137,89	7.215
	20.485.982,64	3.830.596,53	400.000,00	2.854,00	24.713.725,17	5.844.087,68	1.778.780,16	0,00	0,00	1.109,89	7.621.757,95	17.091.967,22	14.642
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und Bauten	10.631.994,92	158.873,23	1.217.777,55	0,00	12.008.645,70	1.889.270,60	679.715,33	615.494,74	6.197,95	0,00	1.959.689,14	10.048.956,56	8.743
2. Technische Anlagen und Maschinen	71.666.286,61	3.382.730,38	3.784.523,19	830.351,59	78.003.188,59	58.922.365,84	3.615.186,51	0,00	0,00	822.589,57	61.714.962,78	16.288.225,81	12.744
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.462.449,79	1.602.505,78 *	40.495,14	261.788,55 *	6.843.662,16	4.112.487,28	820.839,29 *	0,00	-6.197,95	254.129,82 *	4.672.998,80	2.170.663,36	1.350
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.266.544,92	12.152.062,02	-5.442.795,88	513.725,23	9.462.085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462.085,83	3.266
	91.027.276,24	17.296.171,41	-400.000,00	1.605.865,37	106.317.582,28	64.924.123,72	5.115.741,13	615.494,74	0,00	1.076.719,39	68.347.650,72	37.969.931,56	26.103
III. Finanzanlagen													
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	32.348.283,47	45.793.441,02	80.432,00	16.628.449,90	61.593.706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.593.706,59	32.348
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	163.940,71	0,00	0,00	163.940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164
3. Beteiligungen	635.780,77	2.000,00	-80.432,00	0,00	557.348,77	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	247.348,77	326
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.900.309,37	472.309,92	0,00	1.380.488,08	992.131,21	891.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00	0,00	992.131,21	1.009
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	724.344,00	0,00	0,00	0,00	724.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.344,00	724
6. Sonstige Ausleihungen	91.350,00	0,00	0,00	91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92
	35.864.008,32	46.267.750,94	0,00	18.264.228,69	63.867.530,57	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00	310.000,00	63.557.530,57	34.663
	147.377.267,20	67.394.518,88	0,00	19.872.948,06	194.898.838,02	71.969.211,40	6.894.521,29	615.494,74	0,00	1.968.829,28	76.279.408,67	118.619.429,35	75.408

* davon fiktiver Abgang geringwertiger Wirtschaftsgüter in Höhe von EUR 159.281,74

Angaben zum Anteilsbesitz

	Währung	Beteiligungen %	Eigenkapital in TEUR/LW	Ergebnis in Tausend
Inland				
Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt	EUR	33,33	--	--**
attoSENSOR GmbH, Penzberg	EUR	30,00	97,6	1.287,1
ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG, Dortmund	EUR	100,00	173,0	54,8*
ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG, Dortmund	EUR	100,00	92,2	91,1*
ELMOS Semiconductor Süd GmbH, Unterschleißheim	EUR	100,00	187,5	17,9*
Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	EUR	100,00	16,7	2,5
Exedra Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	EUR	94,00	0,8	-5,6
GED Gärtner Elektronik Design GmbH, Frankfurt/Oder	EUR	73,90	345,2	56,3
Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH, Dortmund	EUR	100,00	--	--**
IndustrieAlpine Bauträger GmbH, München	EUR	51,00	--	--**
Mechaless Systems GmbH, Karlsruhe	EUR	51,00	343,1	240,9
Ausland				
Elmos Advanced Packaging B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	17,8	-0,2*
ELMOS California Inc., Milpitas (USA)	USD	100,00	133,9	63,0*
ELMOS Design Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	-425,4	-461,0*
EL-MOS France S.A., Nanterre (F)	EUR	74,97	2.182,5	1.082,1
ELMOS N.A. Inc., Farmington Hills (USA)	USD	100,00	-3.586,5	-940,2*
Elmos Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	73.137,6	27.977,4
ELMOS Quality Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	4.553,1	14.872,6*
Elmos USA Inc., Farmington Hills (USA)	USD	100,00	--	--**
European Semiconductor Assembly (Eurasem) B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	31.548,0	20.050,9*
Micro Systems on Silicon (MOS) Limited, Pretoria (Südafrika)	ZAR	87,00	--	* --**
Silicon Microstructures Inc., Milpitas (USA)	USD	100,0	4.212,3	93,5*

* Es handelt sich um mittelbaren Anteilsbesitz der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund.

** Es liegt bislang kein aktueller Jahresabschluss der Gesellschaft vor.

Forderungen und Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben bis auf einen Betrag von TEUR 854 (Vj. TEUR 627) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind aktivierte Forderungen auf Erstattung von verauslagten Entwicklungskosten in Höhe von TEUR 1.329 (Vj. TEUR 1.492) sowie ein Aktivwert aus einer Rückdeckungsversicherung in Höhe von TEUR 798 (Vj. TEUR 627) enthalten.

Eigenkapital

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2004 aus 19.300.000 auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von EUR 19.300.000,00 ist voll eingezahlt.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 5. April 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu EUR 9.650.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).

Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage kann das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise in dem Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen auszuschließen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.

Das Grundkapital ist um EUR 1.000.000,00, eingeteilt in 1.000.000 nennwertlose Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogramms der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu EUR 5.000.000,00 eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus bis zum 25. April 2007 durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittelbare inländische oder ausländische 100-prozentige Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft gemäß der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 26. April 2002 begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren inländischen oder ausländischen 100-prozentigen Beteiligungsgesellschaften bis zum 25. April 2007 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu nominal EUR 930.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durch Ausgabe von bis zu 930.000 neuen Stückaktien ohne Nennwert mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien und nur zur Einlösung von Bezugsrechten durchgeführt, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der ELMOS Semiconductor AG in dem Zeitraum vom 1. Oktober 2004 bis zum 26. April 2009 gewährt werden. Der Vorstand – und soweit es die Mitglieder des Vorstands betrifft der Aufsichtsrat – wird angewiesen, im Rahmen dieses Aktienoptionsplans 2004 bis zu 930.000 Stück Bezugsrechte auf je 1 Aktie der Gesellschaft an die unten bezeichneten Berechtigten unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in jährlichen Tranchen auszugeben. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der ELMOS Semiconductor AG aus dem bedingten Kapital Bezugsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Bezugsrechte hiervon innerhalb der Ausübungsfrist Gebrauch machen. Jedes Bezugsrecht berechtigt zum Bezug einer Stückaktie ohne Nennwert mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00.

Es bestehen Bezugsrechte gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG aus einem Aktienoptionsprogramm für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter zum Erwerb von 518.157 Aktien.

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von TEUR 26.062 enthalten; im Übrigen verweisen wir auf den unten stehenden Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen wurden für Mitglieder des Vorstandes gebildet.

Die Steuerrückstellungen betreffen Ertragsteuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Tantiemen, Berufsgenossenschaft, Garantieleistungen, Lizenzen, nachkommende Rechnungen, Verluste aus schwebenden Geschäften, Aufsichtsratsvergütungen und steuerliche Risiken gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen dargestellt.

Die Verbindlichkeiten enthalten keine gegenüber Gesellschaftern.

Verbindlichkeitspiegel in TEUR

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit				gesamt 31.12.2003
	gesamt 31.12.2004	unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.245	13.689	556	0	12.714
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	135	135	0	0	28
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.030	8.030	0	0	5.504
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	2.500	2.500	0	0	5.100
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.632	4.632	0	0	4.088
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	10	10	0	0	2
7. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	2.252 (2.127)	1.315 (2.127)	937	0	2.127
- davon aus Steuern (Vorjahr)	317 (354)	317 (354)	0	0	354
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr)	635 (556)	635 (556)	0	0	556

Derivative Finanzinstrumente

Im abgelaufenen Jahr hat die Gesellschaft einen Bonus Zinssatz-Swap für einen Nominalbetrag in Höhe von TEUR 20.000 und einer Laufzeit vom 14. April 2003 bis zum 14. April 2008 abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist der Tausch eines Festzinssatzes in Höhe von 5,250 % p. a. gegen einen variablen Zinssatz in Höhe der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR-Telorate) für 3-Monatsgelder.

Zum Stichtag wurde das Finanzderivat zum Marktwert bewertet. Es wurde eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften in Höhe von TEUR 186 gebildet.

Angabe von Art und Form der Sicherheiten

Die Darlehen sind durch Sicherungsübereignungen diverser angeschaffter Maschinen und Geräte sowie einer Grundschuld am gewerblichen Objekt Emil-Figge-Straße 83 / Heinrich-Hertz-Str. 1 und Joseph-von-Fraunhofer-Str. 9, 44227 Dortmund (Eigentümer: Exedra Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz) gesichert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind, bis auf branchenüblich verlängerte Eigentumsvorbehalte von Lieferanten im Wesentlichen nicht besichert. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ebenfalls nicht besichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat 2003 eine Bürgschaft für eine Kreditlinie in Höhe von USD 1.500.000,00 übernommen, welche einem verbundenen Unternehmen gewährt wurde. Zum Abschlussstichtag hat das verbundene Unternehmen die Kreditlinie in Höhe von USD 1.491.614,00 in Anspruch genommen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat Leasingverträge für das Betriebs- und Verwaltungsgebäude, für Betriebsvorrichtungen und das Parkhaus sowie für ein weiteres Bürogebäude abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2006, 2020, 2021, 2022 und 2030 erstrecken. Außerdem hat die Gesellschaft Leasingverträge für technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2007 erstrecken. Daneben bestehen Leasingverträge für den Fuhrpark, Büromaschinen und technische Anlagen und Maschinen in betriebsüblichem Umfang.

Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden nichtkündbaren oben genannten Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

Leasingverträge

	<u>TEUR</u>
2005	15.405
2006	14.402
2007	4.928
2008	3.737
2009	3.717
Folgejahre	44.802

Aus erteilten Investitionsaufträgen besteht ein Bestellobligo von TEUR 13.454.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	<u>2004</u> <u>TEUR</u>	<u>2003</u> <u>TEUR</u>
nach Sparten:		
Produktion	121.871	98.275
Entwicklung	4.714	4.233
Sonstiges	<u>558</u>	<u>472</u>
Nettoumsatzerlöse	<u><u>127.143</u></u>	<u><u>102.980</u></u>

	<u>2004</u> <u>TEUR</u>	<u>2003</u> <u>TEUR</u>
nach Regionen:		
Inland	60.119	54.936
Übrige EU-Länder	46.453	32.935
USA	11.807	9.893
Übrige Länder	<u>8.764</u>	<u>5.216</u>
Nettoumsatzerlöse	<u><u>127.143</u></u>	<u><u>102.980</u></u>

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Zuschreibung des Finanzanlagevermögens (TEUR 891), Erträge aus Anlagenabgängen (TEUR 30), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 23), Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 555) sowie (außerordentliche) Erträge aus Anpassungen aus Betriebsprüfung (TEUR 672). Darüber hinaus werden im Wesentlichen Erträge aus Währungsdifferenzen, Projektförderungen, privater Pkw-Nutzung, Erhöhung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung, Weiterberechnungen, Mieten, Währungsdifferenzen und aus Schadenserstattungen ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den periodenfremden Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen aus Garantieleistungen (TEUR 802) sowie Forderungsverluste (TEUR 576).

Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer, Duisburg, Institutsleiter (Vorsitzender)

Dr. Burkhard Dreher, Dortmund, Dipl.-Volkswirt (stellvertretender Vorsitzender)

Herbert Sporea, Altwittenbek, Kaufmann

Dr. Roland Mecklinger, Steinfeld-Hausen, Diplom-Ingenieur

Dr. Wolfgang Heinke, Reutlingen, Diplom-Physiker

Dr. Karl-Thomas Neumann, Meine, Diplom-Ingenieur

Herr Prof. Dr. Günter Zimmer übt zwei weitere Aufsichtsratsmandate (Wacker Siltronic AG, active photonics AG), Herr Dr. Burkhard Dreher weitere vier (Deutsche Steinkohle AG bis 24. Mai 2004, Harpen AG, Siepe AG bis 16. November 2004, EKO Stahl GmbH seit 22. Juni 2004), Herr Herbert Sporea übt zwei weitere Mandate (TOP Business AG und Beiratsmitglied der Mechaless Systems GmbH) und Herr Dr. Karl-Thomas Neumann ein weiteres Aufsichtsratsmandat (SupplyOn AG) aus.

Vorstand

Diplom-Kfm. Knut Siegfried Hinrichs, Glückstadt (Vorsitzender)

Dr. rer.-nat. Klaus Weyer, Schwerte

Dr. rer.-nat. Peter Thoma, Unterschleißheim

Diplom-Ing. Reinhard Senf, Iserlohn

Gesamtbezüge des Vorstands

Die Bezüge des Vorstands teilen sich in fixe Bezüge und variable, erfolgsorientierte Bezüge auf, die sich prozentual aus dem Ergebnis des Konzerns vor Steuern ableiten. Eine langfristige Bindung wird durch die Ausgabe von Aktienoptionen erreicht, die jährlich vom Aufsichtsrat gemeinsam und in Übereinstimmung mit dem Aktienoptionsprogramm für die Mitarbeiter unterhalb des Vorstands beschlossen wird.

Demnach betragen die Bezüge des Vorstands für 2004 insgesamt TEUR 1.332. Hiervon entfällt auf den fixen Bestandteil TEUR 897 und auf den variablen Teil TEUR 435.

Bislang wurden von Seiten des Vorstands 120.000 Aktienoptionen, davon 60.000 in 2004 gezeichnet.

Die Mitglieder des Vorstandes halten die folgende Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

Aktienbestand Vorstand

Knut Hinrichs	0 Stück
Dr. Klaus Weyer	10.000 Stück
Dr. Peter Thoma	7.200 Stück
Reinhard Senf	1.948 Stück

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich für 2004 insgesamt auf TEUR 246. Hiervon entfallen auf den fixen Bestandteil TEUR 89 (inkl. Spesen und Auslagen) und auf den variablen Teil TEUR 157.

An Aufsichtsratsmitglieder wurden in 2004 keine Aktienoptionen ausgegeben.

Für sonstige Dienstleistungen – insbesondere Beratungen – vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2004 TEUR 113.

Die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrates halten die angegebene Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

Aktienbestand Aufsichtsrat

Herbert Sporea	2.265 Stück
Dr. Burkhard Dreher	1.900 Stück

Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte

Die folgenden meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte fanden in 2002 statt:

- ZOE-BTG GmbH, Duisburg: Erwerb von 9,5 % der Stimmrechte der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, am 1. April 2002
- Hinrichs GmbH, Glückstadt: Erwerb von 13,3 % der Stimmrechte der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, am 1. April 2002
- Dr. Weyer GmbH, Schwerte: Erwerb von 13,3 % der Stimmrechte der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, am 1. April 2002

Die Stimmrechte werden von der EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, ausgeübt und wurden dort zugeordnet.

Die folgenden meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte fanden in 2004 statt:

- Dr. Klaus Weyer: Verkauf von 5.040 Aktien zu EUR 13,81 am 28. September 2004;
Verkauf von 1.166 Aktien zu EUR 13,84 am 29. September 2004
- Frau Elke Zimmer (Ehefrau von Herrn Prof. Dr. Günter Zimmer):
Kauf von 1.407 Aktien zu EUR 13,07 und von 593 Aktien zu EUR 13,08 am 12. November 2004
- Dr. Peter Thoma: Kauf von 1.000 Aktien zu EUR 12,96 am 30. November 2004

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Gewerbliche Arbeitnehmer	162	160
Angestellte (inkl. Teilzeitkräfte umgerechnet auf Vollzeit)	<u>308</u>	<u>300</u>
	470	460
Auszubildende	<u>28</u>	<u>25</u>
	<u><u>498</u></u>	<u><u>485</u></u>

Konzernverhältnisse

Die ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, befindet sich im mittelbaren Mehrheitsbesitz der EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, die nach § 290 Abs. 2 Nr. 2 HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist. Die Aufstellung eines Konzernabschlusses durch die EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, zum 31. Dezember 2004 erfolgte bislang nicht.

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt (in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat) vor, den Bilanzgewinn von EUR 40.461.865,71 wie folgt zu verwenden:

Es soll eine Ausschüttung in Höhe von EUR 0,21 pro Aktie vorgenommen werden. Der Rest soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Erklärung gemäß § 161 AktG zum Corporate-Governance-Kodex

Die ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, hat für 2003 die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung abgegeben und den Aktionären zugänglich gemacht.

Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, erklären gemäß § 161 Aktiengesetz:

„Die ELMOS Semiconductor AG entspricht den Empfehlungen der »Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex« (kurz: »DCKG«) in der Fassung vom 21. Mai 2003 mit folgenden Ausnahmen:

- Die derzeit gültige D&O-Versicherung für Aufsichtsrat und Vorstand sieht keinen Selbstbehalt für die Organmitglieder vor (DCKG Nr. 3.8). Vor dem Hintergrund der unklaren Rechtslage hinsichtlich der persönlichen Haftung eines einzelnen Organmitglieds wird eine Anpassung der Versicherung zur Zeit nicht vorgenommen.
- Für bereits ausgegebene Aktienoptionen ist keine Begrenzung („Cap“) bei der Vergütung des Vorstands für Aktienoptionen bei außerordentlichen, nicht vorhersehbaren Entwicklungen möglich (DCGK Nr. 4.2.3). Der Aufsichtsrat wird aber ab dem Januar 2004 Aktienoptionen an Vorstandsmitglieder nur noch mit einem Cap ausgegeben.
- Obgleich die Vergütung der Vorstandsmitglieder sowohl im Internet wie auch im Geschäftsbericht aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung (Aktienoptionen) ausgewiesen werden, erfolgen diese Angaben summiert und nicht individualisiert (DCGK 4.2.4).
- Abweichend von den Empfehlungen sieht die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates der ELMOS Semiconductor AG die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen und eines Prüfungsausschusses erst ab einer Anzahl von mehr als sechs Aufsichtsratsmitgliedern vor (DCGK Nr. 5.3.1 und 5.3.2).
- Auch die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben einer festen eine erfolgsorientierte Vergütung. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird, aufgegliedert nach ihren Bestandteilen, sowohl im Internet wie auch im Geschäftsbericht aufgeführt, jedoch nicht individualisiert. Die von der ELMOS Semiconductor AG an die Mitglieder des Aufsichtsrates gezahlten Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere für Beratungs- und Vermittlungsleistungen, werden nicht individualisiert im Anhang zum Konzernabschluss angegeben (DCGK Nr. 5.4.5).“

Dortmund, im Februar 2005

Der Vorstand

Knut Hinrichs

Dr. Klaus Weyer

Dr. Peter Thoma

Reinhard Senf

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

- 1.1 Geschäftstätigkeit und Strategie
- 1.2 Wirtschaftliches Umfeld
- 1.3 Produktion und Kapazitäten
- 1.4 Forschung & Entwicklung
- 1.5 Mitarbeiter
- 1.6 Qualitätswesen
- 1.7 Umwelt- und Arbeitsschutz
- 1.8 Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

2. Ertrags, Finanz- und Vermögenslage

- 2.1 Umsatz- und Ertragslage
- 2.2 Finanz- und Vermögenslage

3. Nachtragsbericht

4. Risikobericht

- 4.1 Risikomanagementsystem
- 4.2 Abhängigkeit von der Automobilindustrie
- 4.3 Wettbewerb und Mitarbeiter
- 4.4 Entwicklung neuer Produkte und Technologien
- 4.5 Beschaffung
- 4.6 Produkthaftung
- 4.7 Betriebsunterbrechung
- 4.8 Beteiligungsbereich

5. Prognosebericht

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

1.1 Geschäftstätigkeit und Strategie

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte zumeist anwendungsspezifische, mikroelektronische Schaltkreise, vornehmlich für die Automobilindustrie. Auch im Jahr 2004 entfielen rund 90 Prozent vom Umsatz auf dieses Marktsegment.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir uns eine führende Marktposition als Halbleiterhersteller im europäischen Markt für Automobilelektronik erarbeitet. In einer Erhebung von Gartner Dataquest wird ELMOS als die weltweite Nummer drei im Segment der ASICs (ASICs = Application Specific Integrated Circuits) für den Automobilmarkt aufgeführt.

Position	Unternehmen	2003 (Mio. USD)	Wachstum 2002-2003	Marktanteil
1	ST Microelectronics	317	31%	26%
2	NEC Electronics	155	28%	13%
3	ELMOS Semiconductor AG	117	38%	10%
4	AMI Semiconductor	103	23%	9%
5	Philips	101	4%	8%
	Sonstige	409	7%	34%
	Gesamt	1,202	19%	100%

Quelle: Gartner Dataquest 2004

Unsere ASICs werden von nahezu allen europäischen Fahrzeugherstellern eingesetzt. Stetig wachsende Anforderungen an die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Umweltverträglichkeit eines Kraftfahrzeugs und insbesondere an Sicherheit und Komfort der Fahrzeuginsassen führen zu immer mehr Elektronik im Auto. Halbleiterbausteine von ELMOS sind ideal geeignet, solche Systeme kompakt, zuverlässig und kostengünstig aufzubauen.

Seit Firmengründung bedienen wir geschützte Nischenmärkte mit eigenem Know-how. Unsere Strategie ist zum einen durch eine konsequent an den Marktbedürfnissen optimierte Fertigungstechnologie und zum anderen durch die kundenspezifische Produktentwicklung gekennzeichnet. So entwickelt ELMOS Produkte in der Regel im Kundenauftrag für eine spezielle Anwendung und produziert diese exklusiv für diesen Kunden. Ziel des Unternehmens ist, als kompetenter Partner der Kunden mit maßgeschneiderten, integrierten Schaltungen ein profitables Geschäft zu betreiben und die eigenen Marktanteile zu erhöhen.

Neben den kundenspezifischen Schaltkreisen, die ca. 80 Prozent der Produkte umfassen, verfügt ELMOS auch über ein Portfolio von frei vermarkteten anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) sowie von mikromechanischen Sensoren aus der Produktion der Tochterfirma SMI.

Alle ASICs produzieren wir selbst. Hierzu betreiben wir in Dortmund eine eigene Produktionsstätte für Halbleiterbauelemente (Wafer-Fab). Sowohl durch die automobil-gerechte Hochvolt-CMOS Technologie als auch durch die systemgerechte Integration von analogen und digitalen Funktionen mit On-Chip Treiberleistungen unterscheidet sich ELMOS von den meisten Wettbewerbern. Darüber hinaus unterstützen unsere produzierenden Tochterfirmen ELMOS Advanced Packaging B.V. (ELAP, vormals eurasem) in den Niederlanden und Silicon Microstructures Inc. (SMI) in den USA das Technologie- und Produktportfolio.

Unter dem Slogan „ASIC^{plus} – more than a chip!“ entwickeln und vermarkten wir anwendungsspezifische mechatronische Module. Diese Module kombinieren die Fähigkeiten der drei produzierenden Unternehmen der ELMOS-Gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden Halbleiterbauelementen, mikromechanischen Sensoren und funktionalem Gehäuse. Damit können wir für Kunden kostengünstige Systemlösungen realisieren.

Neben dem automobilen Markt sind wir auch im Industrie- und Konsumbereich tätig und liefern kundenspezifische Schaltkreise für Anwendungen in Haushaltsgeräten, Fotoapparaten, Installations- und Gebäudetechnik und Maschinensteuerungen. Diese Märkte haben im vergangenen Jahr rund zehn Prozent unseres Umsatzes ausgemacht.

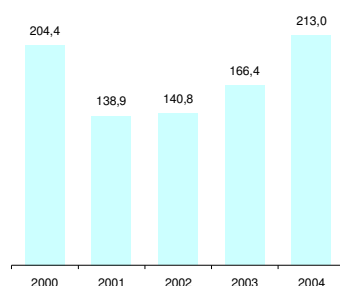
1.2 Wirtschaftliches Umfeld

Als Hersteller von automobilen Halbleitern ist für ELMOS der Halbleitermarkt aus Produktionssicht relevant. Eine mit Abstand höhere Bedeutung für unsere Geschäftsentwicklung haben aber die Abnehmermärkte, welche hauptsächlich von der Automobilproduktion und dabei im besonderen vom Elektrik-/ Elektronikanteil im Fahrzeug abhängig sind.

Halbleitermarkt

Die Halbleiterindustrie konnte in 2004 erstmals nach Jahren wieder ein zweistelliges Umsatzwachstum realisieren. Nach dem Krisenjahr 2001 der Halbleiterindustrie mit einem Umsatzrückgang von 32 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2000, wuchs der Gesamtumsatz von rund 166 Milliarden USD in 2003 auf 213 Milliarden USD in 2004 weltweit weiter an. Damit konnte die Branche im vergangenen Jahr mit einem Umsatzanstieg von fast 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr an zurückliegende hohe Wachstumsraten anknüpfen. Speicherchips für Computer und Mobiltelefone waren die größten Wachstumstreiber in 2004. So übertraf der weltweite Umsatz 2004 sogar noch das hohe Niveau von 2000.

Grafik: Entwicklung des Halbleitermarkts (Milliarden USD)



Quelle: Semiconductor Industry Association (SIA)

Nach einem guten ersten Halbjahr verflieg die Euphorie in der zweiten Jahreshälfte, so dass für den Halbleiterbereich von einer Seitwärtsbewegung in 2005 und erst in 2006 mit einem Aufwärtstrend gerechnet wird.

Die Konjunktur des Halbleitermarktes ist für ELMOS insofern von Bedeutung, als dass die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die bezogenen Leistungen und die Anschaffungskosten für Investitionsgüter konjunkturbedingt schwanken. Außerdem ist das Bestellverhalten der Kunden stark von der allgemeinen Konjunkturlage abhängig. So gibt es in Boomphasen stets überzogene „Angstbestellungen“ und in Flautezeiten deutliche Zurückhaltung.

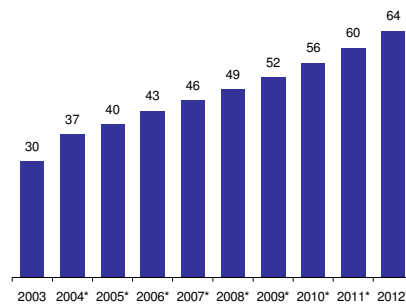
Automobilindustrie und Elektronik im Fahrzeug

Wichtiger als der Halbleitermarkt ist für ELMOS die Entwicklung des Marktes für Automobilelektronik, der rund 90 Prozent des Umsatzes von ELMOS beeinflusst. Veränderungen im automobilen Halbleitermarkt sind zum einen gekennzeichnet durch die Konjunktur der Automobilindustrie und zum anderen durch den wachsenden Elektronikanteil im Automobil.

Für die Automobilindustrie war 2004 ein Ausnahmejahr: So konnten die Automobilzulassungen in 2004 einen deutlichen Zuwachs verzeichnen. Im Vergleich zur rückläufig prognostizierten Tendenz ist dies eine positive Überraschung. Ursache dafür war unter anderem ein kräftiger Jahresendspurt, der in Europa zu einem Zuwachs der Auto-Neuzulassungen um mehr als zwei Prozent geführt hat. Für das gesamte Jahr 2004 ergab sich daraus ein Plus von 2,1 Prozent auf 14,5 Millionen Neuzulassungen; die höchste Zahl seit 2001. Der Autoabsatz in Deutschland stieg im Gesamtjahr 2004 um 0,9 Prozent, der erste Anstieg seit fünf Jahren. In den USA wurden 2004 ein Prozent mehr PKWs verkauft. In Japan wuchs der Markt um sieben Prozent. Damit ergibt sich für den weltweiten Absatz 2004 ein Zuwachs in der Größenordnung von vier Prozent.

Langfristig hat die Automobilproduktion mehr oder weniger stark stagniert. Dennoch profitiert der automobilen Halbleitermarkt, in dem die ELMOS-Gruppe tätig ist, vom langfristigen Trend des steigenden Anteils von Elektronik im Fahrzeug. Das Umsatzwachstum der Automobilelektronik wird weniger durch steigende Zulassungszahlen generiert, sondern vielmehr durch die zunehmende Elektronikausstattung. Die immer höheren Anforderungen an Sicherheit, Komfort und Umweltverträglichkeit sowie der zunehmende Ersatz mechanischer Funktionen durch Elektronik sind hierfür verantwortlich.

Grafik: Elektronikanteil im Auto (Milliarden USD); CAGR 2003 – 2012: 8,7 Prozent



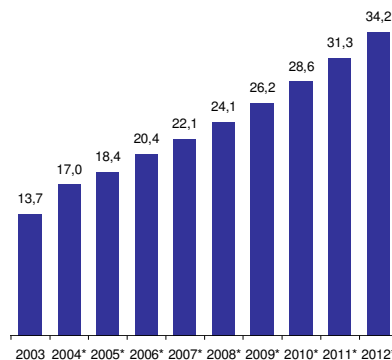
* = Prognose ; Quelle: Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI)

Automobiler Halbleitermarkt

Halbleiterchips für die Automobilindustrie – der Markt, in welchem die ELMOS-Gruppe vorrangig tätig ist – stellen einen interessanten Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie dar. Dieser Spezialmarkt umfasst einen Anteil von rund acht Prozent vom Gesamtmarkt. Bedingt durch den Einfluss der Automobilproduktion und des zunehmenden Anteils der Elektronik im Fahrzeug weist der automobiler Halbleitermarkt eine deutlich höhere Stabilität auf als der globale Halbleitermarkt. Spezielle Differenzierungsmerkmale des automobilen Halbleitermarkts sind die für die Halbleiterbranche untypisch langen Produktlebensdauern und die dadurch bedingten langen Lieferzeiträume von teilweise mehr als zehn Jahren, die langfristigen Kunden-Lieferanten-Beziehungen, die sehr hohen Qualitätsanforderungen und die hohe Planungssicherheit.

Der von ELMOS maßgeblich adressierte Markt ist wiederum nur ein Teil des automobilen Halbleitermarkts, nämlich der der vorwiegend kundenspezifischen Halbleiter. Wegen der vergleichsweise geringen Jahresstückzahlen stehen die ASICs nicht im Fokus der großen Halbleiterhersteller, die Auslastung für ihre großen Produktionskapazitäten suchen. Weitere Differenzierungsmerkmale des ASIC-Geschäftes sind sehr enge Lieferbeziehungen des Kunden zu einem einzelnen ASIC-Hersteller, die aus seinem Wunsch nach Schutz des eigenen Know-hows entstehen. Dieser Markt wird daher vor allem von kleinen bis mittelgroßen Anbietern bedient, mit denen ELMOS im Wettbewerb steht. Dazu zählen vor allem AMI Semiconductor, Bosch (Halbleiterdivision) und Melexis.

Grafik: Entwicklung des automobilen Halbleitermarkts (Milliarden USD); CAGR 2003 – 2012: 10,7 Prozent



* = Prognose; Quelle: Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI)

Der hohe Ausrüstungsstand der europäischen Fahrzeuge markiert dabei nur das Niveau, dem sich zunehmend die Fahrzeughersteller in anderen Kontinenten annähern. Es gilt daher zweifelsfrei: Der Elektronikanteil im Automobil wächst auch in Zukunft weiterhin. Der Anteil der Elektrik / Elektronik am Fahrzeugwert wird einen Wert von etwa 35 bis 40 Prozent im Jahr 2010 erreichen. ELMOS ist mit den spezialisierten ASICs für solche Anwendungen in fast allen Wachstumssegmenten herausragend positioniert.

1.3 Produktion und Kapazitäten

Seit 1999 produziert ELMOS ausschließlich auf der 150mm-Wafer-Linie (entspricht 6-Zoll) in Dortmund. Diese wurde auch in 2004 weiter planmäßig ausgebaut, um für die nächsten Technologie-Generationen und den steigenden Kapazitätsbedarf der Produktion vorbereitet zu sein. Die Produktionsräume und -anlagen am Standort Dortmund sind für Prozesse mit Strukturbreiten bis 0,35 Mikrometer auf den modernsten Stand der Technik ausgelegt. Sie bilden damit eine solide Plattform für die ELMOS-Produktion der nächsten zehn Jahre. Die Maschinenkapazität lag zum Jahresende bei etwa 450 Waferstarts pro Tag, wovon etwa 380 Waferstarts pro Tag genutzt wurden – rund 85 Prozent im Vergleich zu rund 70 Prozent in 2003. Insgesamt wurden in 2004 über 120.000 Wafer gefertigt.

In 2004 haben wir ca. 150 verschiedene Produkte mit nennenswertem Umsatz parallel produziert, davon sind 21 neu in die Produktionsphase überführt worden. Damit kennzeichneten zahlreiche Produktneuanläufe auch das Jahr 2004.

Zukünftige Kapazitäten

Als selbst produzierendes Unternehmen ist für ELMOS die Bereitstellung der in Zukunft benötigten Produktionskapazitäten von entscheidender Bedeutung. Gerade da die Investitionen in die Produktion den wesentlichen Teil des gesamten Investitionsbudgets ausmachen, ist eine sorgfältige und langfristige Planung notwendig. Die Kapazität der bestehenden Produktionslinie in Dortmund kann nach wie vor durch Rekrutierung weiterer Mitarbeiter und durch weitere Investitionen in Maschinen und Ausbau von Räumen erweitert werden. Durch die im Jahr 2004 eingeleiteten Maßnahmen können weitere Nebenflächen der Produktion mittelfristig zugeführt werden, wodurch sich die Kapazität auf bis zu 600 Waferstarts pro Tag ausbauen lässt. Dies übertrifft unsere früheren Annahmen von maximal 500 Waferstarts pro Tag. Damit könnte genügend Fertigungskapazität für das geplante Wachstum in den kommenden zwei bis drei Jahren dargestellt werden.

Zur weiteren Absicherung der Produktionskapazitäten betreibt ELMOS seit Ende 2003 ein Kooperationsvorhaben mit dem Fraunhofer-Institut für mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg mit dem Ziel, mit der Fraunhofer Gesellschaft einen Vertrag über die Nutzung und den Betrieb der Fertigungslinie des Institutes abzuschließen. Das IMS verfügt über eine 200mm-Wafer-Linie (entspricht 8-Zoll) für Forschungszwecke. Hier kann aus heutiger Sicht für ELMOS eine Kapazität von bis zu 200 Waferstarts pro Tag aufgebaut werden. Im Jahr 2004 wurde planmäßig mit dem Prozesstransfer begonnen und erste Versuchschargen in Duisburg gefertigt. In 2005 sollen die ersten Produkte auf der 200mm-Linie qualifiziert werden, so dass in 2006 die ersten Serienfertigungen starten können.

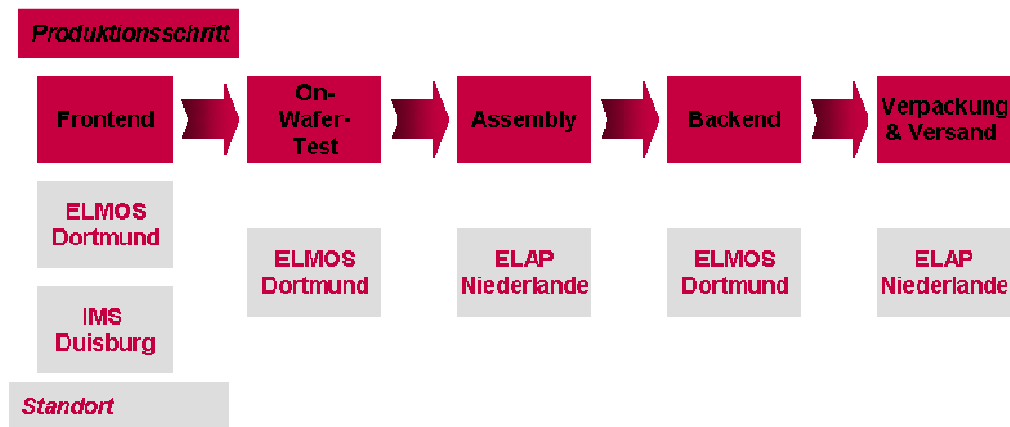
Da die Fertigung auf den größeren 200mm Wafern Kostenvorteile bringt, sollen zunächst die IMS-Kapazitäten ausgelastet werden. Nachfolgend sollen die Kapazitäten in Dortmund auf Basis von 150mm oder eventuell sogar von 200mm Wafern erweitert werden.

Unabhängig davon ist bereits im Jahr 2005 eine Erweiterung der Kapazität des Backends in Dortmund notwendig. Der ursprüngliche Plan sah hier die schrittweise Verlagerung von Testkapazität zur niederländischen Tochter ELAP vor. In jedem Fall war die Errichtung eines Backend-Reinraums geeigneter Größe entweder in Holland oder in Dortmund erforderlich. Die Entscheidung fiel für den Ausbau in Dortmund, da dies den Vorteil bietet, dass der komplette Testbereich unter einheitlicher Leitung an einem Standort durchgeführt wird.

ELAP in den Niederlanden übernimmt allerdings zusätzlich zum Assembly die bislang in Dortmund verrichteten Produktionsschritte Verpackung und Logistik.

Damit wird die Wertschöpfungskette zukünftig wie in folgender Grafik aussehen.

Grafik: Typische Produktionsschritte eines ELMOS ASICs



1.4 Forschung und Entwicklung

Sowohl im Automobil- wie auch im Konsum- und Industriebereich agiert ELMOS stets aus einer geschützten Position heraus, entweder technologiebedingt oder aufgrund speziellen Anwendungs-Know-hows. Die nicht automobilen Märkte haben sowohl in der Vergangenheit wie auch heute der ELMOS-Gruppe als Innovationstreiber gedient. Die hohen Anforderungen der Automobilindustrie an Qualität und Zuverlässigkeit der Halbleiter sowie die langen Entwicklungszeiten bis zur Serienproduktion erschweren die Weiterentwicklung der in sonstigen Märkten so schnelllebigen Halbleitertechnologien. Die schnelllebige Produktentwicklung mit vergleichsweise geringeren technologischen Anforderungen der Industrie- und Konsummärkte machen es möglich, neuere Technologien in kurzer Zeit umzusetzen. Die Technologien für diese innovationstreibenden Märkte werden nachfolgend auch im Automobilmarkt eingesetzt.

Die Aktivitäten zur Entwicklung neuer Prozesstechnologien mit kleineren Strukturgrößen und Flash-Option sowie die Weiterentwicklung der Silicon-On-Insulator-Technologie (SOI) machen einen Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung aus. Die F&E-Arbeiten der Technologen und Prozessingenieure konzentrierten sich im Jahr 2004 auf die Produktionseinführung der 0,5µm Hochvolt-Prozesstechnologie, die Weiterentwicklung der Flash-Option und die Strukturverkleinerung (Shrink) bei der SOI-Technologie. Parallel dazu liefen mehrere Projekte zur Optimierung von Baugröße und Eigenschaften wichtiger Hochvoltbauelemente, die für typische ELMOS-Anwendungen von Bedeutung sind. Damit verfolgt ELMOS konsequent die Strategie, stets durch eigene Prozesstechnologien innovative und wettbewerbsüberlegene Lösungen anbieten zu können.

Neben den Entwicklungen neuer Prozesse entfällt der mit Abstand größere Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf die Entwicklung neuer Produkte. Wie schon in der Vergangenheit haben im Jahr 2004 die Kunden weiterhin Druck dahingehend ausgeübt, dass die Lieferanten die Kosten für Forschung und Entwicklung eines ASICs übernehmen. Dies bedeutet, dass ein Großteil der Produktentwicklungskosten vom ASIC Lieferanten, das heißt ELMOS, vorfinanziert werden muss und sich erst über die Serienstückfertigung amortisieren kann. Darüber hinaus haben die Automobilhersteller weiterhin forciert, dass ihre Zulieferer Verantwortung für Systeme übernehmen, welche diese ihrerseits an die Zulieferer der zweiten Reihe weitergeben. Diese Aufgaben werden somit zunehmend von ELMOS übernommen.

1.5 Mitarbeiter

Als Technologieunternehmen profitiert ELMOS in besonderem Maße vom Know-how der Mitarbeiter. Deren Motivation, Wissen und Flexibilität sind die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für das Wachstum und die Innovationskraft. Am Standort Dortmund in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland, kann ELMOS auf eine große Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren zugreifen, denn im näheren Umkreis befinden sich mehr als fünfzig Universitäten und Hochschulen. ELMOS hat als einziger Halbleiterhersteller der Region eine Ausnahmestellung. Daher ist auch in Zeiten mit rückläufigen Studentenzahlen in den Ingenieurwissenschaften der Nachwuchs gesichert. Schon seit der Gründung kooperiert ELMOS eng mit den

umliegenden Universitäten, Hochschulen und Instituten, wobei viele Mitarbeiter als studentische Hilfskräfte bei ELMOS begonnen haben und heute Führungsaufgaben wahrnehmen. Die meisten sind daher schon viele Jahre bei ELMOS.

Trotz eines strikten Sparkurses gehörte ELMOS auch im Jahr 2004 zu den wenigen Unternehmen, die neue Arbeitsplätze geschaffen haben. Die ELMOS Semiconductor AG beschäftigte im Geschäftsjahr 2004 im Mittel insgesamt 498 Mitarbeiter gegenüber 485 Mitarbeitern in 2003.

Im Jahr 2004 hat ELMOS anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums und in Anbetracht der schwierigen Lage auf dem Ausbildungsmarkt 20 zusätzliche Auszubildende eingestellt, so dass in 2004 insgesamt 35 Auszubildende ihre Ausbildung bei ELMOS begonnen haben. Knapp die Hälfte der neuen Auszubildenden erlernt den Beruf des Mikrotechnologen, welcher Ende der 90er Jahre entstanden ist und maßgeblich von ELMOS mitgestaltet wurde. Neben Mikrotechnologen bildet ELMOS Physiklaboranten, Elektroniker für Betriebstechnik, Kaufleute für Bürokommunikation, Fachkräfte für Lagerwirtschaft, Industriekaufleute, Informations- und Telekommunikations-Elektroniker, Fachinformatiker, Informatikkaufleute und Elektroinstallateure aus.

Der Vorstand und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Dortmund vertrauensvoll zusammen. Eine Mitarbeitervertretung mit selbst gegebener Satzung vertritt in zahlreichen Ausschüssen die Belange der Mitarbeiter untereinander und im Verhältnis zur Geschäftsleitung. So gibt es Ausschüsse für soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiterförderung und Wirtschaft.

Aktienoptionsprogramme

Eine langfristige Bindung an das Unternehmen und eine Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird über jährliche Aktienoptions-Programme erreicht. Diese Programme sehen die Ausgabe von Aktienoptionen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterhalb des Vorstands und zu identischen Bedingungen an den Vorstand vor. Als zusätzliche Bedingung wurde für die Aktienoptionen der Mitglieder des Vorstands mit dem Aktienoptionsprogramm 2004 eine Begrenzung der Wertsteigerung eingeführt. Für die Vorstandsmitglieder dienen die Aktienoptionen gleichzeitig als variable Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung.

Für das Aktienoptions-Programm steht durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27. April 2004 ein bedingtes Kapital bis zu einem Betrag von 930.000 Euro zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 17. Dezember 2004 den Beschluss des Vorstands über die Ausgabe von bis zu 160.000 Aktienoptionen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterhalb des Vorstands sowie 40.000 Aktienoptionen für den Vorstand zu einem Ausgabekurs von 13,98 Euro genehmigt. Der Ausgabebetrag pro Option bestimmt sich aus dem Zehn-Tage-Mittel des amtlichen Börsenkurses der ELMOS-Aktie vor dem Beschlusstag und einer Ausübungshürde in Höhe von zehn Prozent. Die Optionen können frühestens nach einer Frist von zwei Jahren ausgeübt werden und haben danach eine Laufzeit von drei Jahren. Die Ausübung kann nur in bestimmten zeitlichen Fenstern erfolgen.

Von Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Vorstands wurden 295.722 Aktienoptionen aus dem Optionsprogramm des Jahres 2003 im Jahr 2004 gezeichnet. Zum 31. Dezember 2004 standen insgesamt 803.210 Aktienoptionen aus den Programmen der Jahre 1999 bis 2003 aus. Bisher wurden jedoch keine Optionen ausgeübt.

1.6 Qualitätswesen

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS konsequent seine Null-Fehler-Strategie um und erzielt damit ein hervorragendes automobilgerechtes Qualitätsniveau. Regelmäßige Prüfungen der eingesetzten Werkzeuge, die Betreuung der Serienprodukte von der Entwicklung bis zur Fertigung, ständige Analysen und statistische Verfahren ermöglichen das hohe Qualitätsniveau. Interne Labore prüfen nicht nur mögliche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung, sondern auch sensor- und gehäusespezifische Merkmale.

ELMOS betreibt seit Mitte der Neunziger Jahre ein Qualitätsmanagementsystem, das alljährlich gemäß den Forderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1 zertifiziert wird. Diese Normen wurden inzwischen in der ISO / TS 16949, die weltweite Gültigkeit hat, zusammengefasst. ELMOS Dortmund, ELMOS North America, ELMOS France und GED wurden in 2004 gemäß der neuen Norm auditiert und zertifiziert.

Wie bereits im letzten Geschäftsbericht erwähnt hat ELMOS im Februar 2004 für die exzellente Qualität ihrer Produkte den begehrten „Delphi Electronic Europe Supplier of the Year 2003“ Preis gewonnen. Dies zeigt, dass

ELMOS sich durchaus gegen die großen Halbleiterhersteller durchsetzen kann und die Qualität von ELMOS geschätzt wird.

1.7 Umwelt- und Arbeitsschutz

Arbeitssicherheit und Umweltschutz sind neben der Qualität der Produkte und der Wirtschaftlichkeit als gleichrangige Unternehmensziele festgelegt. Zu den Grundsätzen der Umweltpolitik bei ELMOS am Standort Dortmund zählen Rechtskonformität, Minimierung von Umweltbelastungen, Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter, Umweltschutz-Management, kontinuierliche Verbesserung und Kommunikation.

Das Umweltmanagement gemäß DIN EN ISO 14001 wurde am Standort Dortmund erstmals im Jahr 2003 (durch den TÜV Rheinland) zertifiziert. 2004 erfolgte die Bestätigung anhand eines Überwachungsaudits ohne Abweichungen.

Grafik: Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001



Die Bereiche Arbeits- und Umweltschutz sind direkt dem Vorstand unterstellt. Die ISO 14001 verankert den Umweltschutz systematisch und dauerhaft im Management. ELMOS legt beim Umweltmanagement besonderen Wert auf eine effektive Prävention sowie eine effiziente Ausnutzung von Ressourcen. Beispielsweise konnten in der Produktion erhebliche Mengen an Schwefelsäure durch Optimierung von Produktionsprozessen eingespart werden.

Darüber hinaus hat ELMOS in 2004 den Umweltbericht für das Geschäftsjahr 2003 vorgelegt. Er informiert ausführlich über die umweltrelevanten Tätigkeiten, die davon ausgehenden Umweltauswirkungen sowie über die Organisation der Arbeitssicherheit. Beispielsweise konnte der produktbezogene Wasserverbrauch um mehr als 15 Prozent gegenüber 2002 gesenkt werden. Auch der relative Strom- und Erdgasverbrauch wurde 2003 im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

1.8 Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die EFH ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) ist mit einem mittelbaren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 57,7 Prozent größter Einzelaktionär der ELMOS Semiconductor AG. Daher haben wir gemäß § 312 AktG einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der mit folgender Erklärung gemäß § 312 Abs. 3 AktG abschließt.

„Wir erklären, dass unsere Gesellschaft nach den Umständen, die uns zum Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen und die Maßnahmen getroffen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Nachteile im Sinne von § 312 AktG haben sich aus den Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für uns nicht ergeben.“

2. Geschäftsverlauf und Lage der ELMOS Semiconductor AG

2.1 Umsatz- und Ertragslage

Tabelle: Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG nach HGB

In Millionen Euro	Einheit	2003	2004	Veränderung
Umsatzerlöse	Millionen Euro	103,0	127,1	24%
Personalaufwand	Millionen Euro	26,1	28,2	8%
Materialaufwand	Millionen Euro	30,7	41,1	34%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Millionen Euro	13,8	23,7	71%
Jahresüberschuss	Millionen Euro	8,1	14,4	78%

Im Jahr 2004 konnte ELMOS wieder zu alten Wachstumsraten zurückkehren. Der Umsatz stieg im Jahr 2004 im Vergleich zum Vorjahr um 24,2 Millionen Euro oder 24 Prozent auf 127,1 Millionen Euro. Dies ist das Resultat der gewonnenen Neuprojekte der vergangenen Jahre.

Auftragseingang

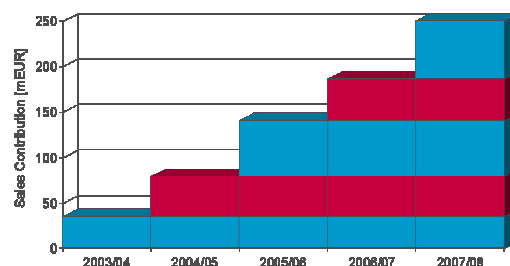
Nach starken Auftragseingängen in der ersten Jahreshälfte kam es ab August 2004 zu einer deutlichen Abschwächung. Das Bestellverhalten unserer Kunden ist trotz geringer Korrelation mit dem Halbleitermarkt durch dessen Gesamtsituation gekennzeichnet. Der Marktzyklus mit Überhitzungserscheinungen im ersten Halbjahr und entsprechenden vorsorglichen Bestellungen führte zu einem vorsichtigeren Bestellverhalten in der zweiten Jahreshälfte. Auf Jahresbasis sank das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz im Halbleiterbereich auf einen Wert von 0,97 gegenüber dem Vorjahr mit dem Wert von 1,13.

Neuprojekte/ Design Wins

Die Basis für das langfristige Wachstum von ELMOS wird im Wesentlichen durch die Akquisition von Neuprojekten bestimmt. Das nachhaltige Interesse unserer Kunden an individuellen Lösungen zeigt sich in der hohen Anzahl neu gewonnener Entwicklungsprojekte. So konnten im abgelaufenen Jahr 29 Entwicklungsprojekte (2003: 31 Projekte), auch Design Wins genannt, mit einem geplanten Umsatzvolumen über den Lebenszyklus von rund 340 Millionen Euro (2003: 227 Millionen Euro) akquiriert werden.

Die Mehrzahl dieser Projekte, nämlich 22, sind kundenspezifische Aufträge (ASICs) und werden erst etwa drei Jahre nach Produktentwicklung, Qualifikation und Freigabe durch den Kunden umsatzwirksam. Die restlichen sieben Projekte sind anwendungsspezifische Standardprodukte (ASSPs). Die von uns vermarkteten ASSPs sind in der Regel Derivate oder Verallgemeinerungen von ASICs, die sich stets durch innovative Eigenschaften auszeichnen.

Grafik: Design Win Pipeline; Aussage: Design Wins bilden die Basis für zukünftiges Umsatzwachstum



Annahme: Fünf Jahre Produktlebenszyklus

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnte um 71 Prozent auf 23,7 Millionen Euro und der Jahresüberschuss um 78 Prozent auf 14,4 Millionen Euro gesteigert werden. Der Gewinnvortrag aus dem Jahr 2003 beträgt 26,1 Millionen Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 26. April 2005 vor, eine Dividende von 0,21 Euro je Aktie auszuschütten. Diese Ausschüttung würde einer Dividendensumme von 4,1 Millionen Euro entsprechen.

2.2 Finanz- und Vermögenslage

Tabelle: Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG nach HGB

<i>In Millionen Euro</i>	Einheit	2003	2004	Veränderung
Immaterielle Vermögensgegenstände	Millionen Euro	14,6	17,1	17%
Sachanlagen	Millionen Euro	26,1	38,0	46%
Finanzanlagen	Millionen Euro	34,7	63,6	83%
Vorräte	Millionen Euro	18,0	19,9	11%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Millionen Euro	56,6	32,3	-43%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	Millionen Euro	15,2	12,6	-17%
Rechnungsabgrenzungsposten	Millionen Euro	2,9	2,0	-31%
Summe, Aktiva	Millionen Euro	168,2	185,5	10%
Eigenkapital	Millionen Euro	132,0	143,9	9%
Rückstellungen	Millionen Euro	6,7	9,8	47%
Verbindlichkeiten	Millionen Euro	29,6	31,8	8%
Rechnungsabgrenzungsposten	Millionen Euro	0	0	-
Summe, Passiva	Millionen Euro	168,2	185,5	10%

Das Gesamtvermögen der ELMOS Semiconductor AG stieg im Jahr 2003 von 168,2 Millionen Euro um 10 Prozent auf 185,5 Millionen Euro. Hauptgrund für diesen Anstieg war die Zunahme des Anlagevermögens und dabei insbesondere der Anteile an verbundenen Unternehmen. Der Kassenbestand sank von 15,2 Millionen Euro auf 12,6 Millionen Euro. Auf der Passivseite der Bilanz spiegelte sich der Anstieg der Bilanzsumme hauptsächlich im Eigenkapital wider, welches von 132,0 Millionen Euro auf 143,9 Millionen Euro zunahm.

3. Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten.

4. Risikobericht

4.1 Risikomanagementsystem

Die ELMOS Semiconductor AG hat im Berichtsjahr das in 2002 eingerichtete umfassende Risikomanagementsystem, das die Anforderungen des § 91 (2) AktG erfüllt, Zug um Zug auf die Unternehmen im Konzern angewendet und weiter verfeinert. Das Risikomanagementsystem und seine Anwendung wurde von unserer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Jahresende kritisch auf Konformität mit den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes geprüft und für geeignet befunden. Es sieht die regelmäßige Erfassung und Bewertung von neuen und bekannten Risiken durch die verantwortlichen Mitarbeiter vor und legt ein geschlossenes Reporting-System fest. Die Unternehmensbereiche der ELMOS-Gruppe berichten auf monatlicher Basis über die finanzielle und operative Entwicklung. Im Jahr 2004 wurde das Risikomanagementreporting auf eine intranetbasierte Eingabe umgestellt. Damit ist eine einfachere und zuverlässige Erhebung der Daten und Verteilung der Information möglich. Durch diese Maßnahmen werden Vorstand und Aufsichtsrat regelmäßig und frühzeitig über die Risikolage informiert und können geeignete Maßnahmen zur Risikominderung beziehungsweise Risikovermeidung oder -abwehr beschließen. Das Risikomanagementsystem wird auch 2005 kontinuierlich erweitert und entsprechend sich ändernder Rahmenbedingungen verbessert werden.

Es ist die Strategie von ELMOS, Zins- und Währungsrisiken durch geeignete Instrumente, wie entsprechende Derivatprodukte, abzusichern.

4.2 Abhängigkeit von der Automobilindustrie

Das Kerngeschäft von ELMOS steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage der Automobilindustrie nach ASICs. Rund 90% des Umsatzes wird mit ASICs für die Automobilelektronik erwirtschaftet. Diese Nachfrage ist einerseits abhängig von den produzierten Stückzahlen an Fahrzeugen und wird andererseits von dem anhaltenden Trend zu mehr Elektronik im Auto gesteuert. Durch die Zunahme an elektronischer Ausrüstung im Auto steigen die Stückzahlen an verkauften ASICs auch dann, wenn die Zahl der produzierten PKWs abnimmt.

Dabei ist zu beobachten, dass die Automobilindustrie häufig in absatzschwächeren Zeiten die Fahrzeuge mit höherwertiger Ausrüstung zum Komplettpreis anbietet, so dass auch bei stagnierender oder zurückgehender Automobilproduktion die Zahl der verkauften ASICs nicht notwendigerweise sinkt. Die Nachfrage nach ASICs ist damit relativ robust und unterliegt nur bedingt den Schwankungen der Kfz-Stückzahlen.

Der Automobilmarkt unterlag in der Vergangenheit als Folge von Zusammenschlüssen von Herstellern, restriktiver Umweltgesetzgebung und anderen Faktoren, beachtlichen Schwankungen. Die ELMOS-Kundenstruktur lässt sicherlich eine gewisse Abhängigkeit von einigen großen Automobilzulieferern erkennen. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der von einem Kunden generierte Umsatz in der Regel nicht durch ein Produkt entsteht, d.h. auch überlappende Lebenszyklen damit verbunden sind. Aufgrund der Bedeutung und der Spezialisierung der ASICs von ELMOS für das Produkt des Automobilzulieferers handelt es sich bei der Beziehung zum Kunden um eine gegenseitige Abhängigkeit. Daher können größere Umsatzvolumina mit einigen Großkunden auch auf vielversprechende langfristige Kundenbeziehungen mit entsprechenden Umsatzpotenzialen hindeuten. Es kommt nur sehr selten vor, dass ein und derselbe ASIC an zwei Lieferanten gleichzeitig vergeben wird, da die Automobilzulieferer selbst unter erheblichem Kostendruck stehen und die gleichzeitige Entwicklung eines ASICs durch zwei Lieferanten erhebliche Mehrkosten zunächst im Entwicklungsbereich und später wegen der geringeren Stückzahlen für den einzelnen ASIC-Lieferanten auch im Fertigungsbereich bedeuten.

4.3 Wettbewerb und Mitarbeiter

Eine Vielzahl von Wettbewerbern im Halbleitermarkt für automobiler Anwendungen bietet ähnliche Produkte wie ELMOS auf ähnlicher technologischer Grundlage an. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass große Halbleiterhersteller, die bisher noch gar nicht oder nur zu einem geringen Prozentsatz im automobilen

Halbleitermarkt tätig sind, in Zukunft versuchen werden, in dieses Marktsegment einzudringen. Dies geschieht insbesondere in Phasen, in denen das klassische Halbleitergeschäft in den Bereichen Speicherchips und Telekommunikation Rückgänge zu verzeichnen hat. Derartige Versuche konnten im Jahr 2004 bei mehreren Wettbewerbern beobachtet werden. Da diese Großproduzenten aus Rentabilitätsgründen sich allerdings auf großvolumige Projekte fokussieren müssen, ist ihr Engagement im Nischenmarkt der kundenspezifischen Schaltungen stets relativ gering. Damit erscheint das Risiko für ELMOS vergleichsweise gering. Allerdings akquiriert ELMOS in letzter Zeit auch vermehrt großvolumigere Aufträge. Dadurch wird ELMOS in Zukunft mehr in Wettbewerb zu Großproduzenten treten und entsprechenden Preisdruck spüren.

Die sehr entwicklungsintensive Geschäftstätigkeit des Unternehmens führt zu einem stark ausgeprägten und sehr spezifischen Ingenieur-Know-how – jedoch nur teilweise zu Patenten. Somit ergibt sich für ELMOS eine erhöhte Abhängigkeit von bestimmten Mitarbeitern. Das Fluktuationsrisiko reduziert sich bei ELMOS durch die erkennbar hohe Motivation und Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Die Mitarbeiter sind beispielsweise über ein Aktienoptions-Programm am Erfolg der ELMOS beteiligt.

4.4 Entwicklung neuer Produkte und Technologien

Bei der kundenspezifischen Entwicklung von Produkten ist zu berücksichtigen, dass bei der Akquisition eines neuen Auftrages die Einmalkosten im Entwicklungsbereich heute in der Regel nicht mehr in vollem Umfang als Vorabzahlung von den Kunden erlangt werden können. Diese vorab nicht gedeckten Entwicklungskosten werden über die späteren Stückzahlen in der Serie amortisiert. Hier besteht das Risiko, dass bei Entwicklungen, die nicht in eine Lieferbeziehung münden, nicht amortisierte Kosten bei der Gesellschaft verbleiben. In der Vergangenheit war die Anzahl der Produkte, die nicht in einer Lieferbeziehung endeten, jedoch sehr gering.

Der Markt für die ELMOS-Produkte ist durch ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte gekennzeichnet. Der ELMOS-Erfolg ist deshalb stark von der Fähigkeit abhängig, neue komplexe Produkte preisgünstig zu entwickeln, sie rechtzeitig im Markt einzuführen und zu erreichen, dass diese Produkte von führenden Zulieferern der Automobilindustrie ausgewählt werden.

Der zukünftige Erfolg von ELMOS ist auch von der Fähigkeit abhängig, neue Entwicklungs- und Produktionstechnologien zu entwickeln. ELMOS entwickelt analoge und digitale Halbleiterstrukturen und -funktionen für ihre selbst entwickelte modulare Hochvolt-CMOS-Prozesstechnologie. Wie auch die Konkurrenten muss ELMOS ihre Technologie ständig weiterverbessern und neue Prozesstechnologien für die fortschreitende Verkleinerung der Strukturen im Submikronbereich entwickeln.

Sollte ELMOS zukünftig nicht in der Lage sein, neue Produkte und Produktverbesserungen zu entwickeln, zu produzieren und abzusetzen, dürfte dies signifikante Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Durch die Fähigkeit von ELMOS, ASICs für alle Arten von elektronischen Geräten im Automobil zu entwickeln und zu fertigen, sind ELMOS-Produkte in fast allen elektronischen Komponenten eines PKW vertreten, so dass das Risiko des Wegfalls eines Auftrages für eine einzelne elektronische Komponente breit gestreut und praktisch nicht vorhanden ist. Zwar könnte ein mehrjähriger Einbruch der Automobilindustrie, der die Automobilunternehmen veranlasst, keine neuen elektronischen Produkte zu entwickeln, die Gesellschaft in ihrer Entwicklung nachhaltig beeinträchtigen. Ein derartiger Einbruch ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abzusehen, insbesondere weil – wie bereits oben erwähnt – die Automobilindustrie in schlechteren Zeiten eher dazu neigt, die technische Ausstattung zu erhöhen. Außerdem ersetzen kundenspezifische ASICs von ELMOS in zunehmendem Maße elektronische Standardbauteile, so dass ELMOS stärker als der Gesamtmarkt wachsen und ihren Marktanteil vergrößern kann. So können selbst Risiken, die mit dem eventuellen Verlust von Entwicklungsaufträgen für ASICs in der Automobilindustrie verknüpft sind, reduziert werden.

Die derzeitige Fertigungskapazität von ELMOS ist für das geplante Wachstum in 2005 und 2006 ausreichend. Parallel zum Ausbau der Fertigung in Dortmund wurde im Jahr 2004 mit dem Prozesstransfer zum Fraunhofer-Institut in Duisburg begonnen, das ab 2006 als weiterer Fertigungsstandort hinzu kommen wird. Damit erhält ELMOS Zugang zu einer zusätzlichen Fertigungskapazität für in der Spitze etwa 200 8-Zoll-Wafer, die für ein geplantes Umsatzwachstum bis zum Ende dieser Dekade ausreicht.

4.5 Beschaffung

Die von ELMOS für die Fertigung benötigten Rohstoffe sind weltweit bei verschiedenen Lieferanten verfügbar und unterliegen keinem Monopol. Branchentypisch ist dabei eine gewisse Abhängigkeit von einzelnen fernöstlichen Partnern im Assembly-Bereich. Hier hat ELMOS mit dem Erwerb der ELMOS Advanced Packaging jedoch die Weichen für eine vertikale Vertiefung der Wertschöpfungskette gestellt. ELMOS Advanced Packaging hat zum Jahresende 2004 etwa 57 Prozent der von ELMOS benötigten Assembly-Dienstleistungen erbracht. Dadurch wird ELMOS zunehmend von den fernöstlichen Partnern bzw. von Dollarschwankungen unabhängiger.

4.6 Produkthaftung

Die von ELMOS produzierten ASICs werden als Komponenten in komplexe elektronische Systeme integriert. Fehler oder Funktionsmängel der von ELMOS hergestellten ASICs oder der elektronischen Systeme, in die sie integriert sind, können direkt oder indirekt Eigentum, Gesundheit oder Leben Dritter beeinträchtigen. ELMOS ist nicht in der Lage, ihre Haftung gegenüber Abnehmern oder Dritten in ihren Absatzverträgen zu reduzieren oder auszuschließen.

ELMOS verfolgt konsequent eine Null-Fehler-Strategie und investiert stetig in die Erkennung und Vermeidung von Fehlerquellen und Fehlern. So werden die einzelnen Halbleiterchips hinsichtlich ihrer Qualität und Funktion im Werk im Regelfall gleich mehrfach bei unterschiedlichen Temperaturen getestet. Obwohl die Gesellschaft die nach TS 16949, VDA 6.1 und QS 9000 zertifizierten Qualitätskontrollsysteme sowie weitreichende Testverfahren vor der Auslieferung ihrer Produkte einsetzt, können sich Produktfehler möglicherweise erst nach Installation und Gebrauch der Produkte durch den Endverbraucher zeigen.

Wenn solche Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwendige Produktmodifikationen nach sich ziehen und zu Störungen der Kundenbeziehungen sowie zum Verlust von Marktanteilen führen. Ein Qualitätsproblem ganzer Chargen könnte zudem zu Regressansprüchen der Kunden im Millionenbereich führen. Dieses Risiko ist angemessen versichert. All dies könnte jedoch negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

4.7 Betriebsunterbrechung

Neben den bereits dargestellten und erläuterten Geschäftsrisiken ist unseres Erachtens das einzige betriebliche Risiko, das die Entwicklung der Gesellschaft wesentlich beeinträchtigen und den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnte, das Risiko der Zerstörung der Fertigungsanlagen durch Feuer oder andere Katastrophen. Zwar ist das Betriebsunterbrechungsrisiko durch solche Ereignisse angemessen versichert, jedoch bestünde in einem solchen Fall eine erhebliche Gefahr des Verlustes von Schlüsselkunden. Dieses Risiko ist nicht versicherbar.

Dieses Risiko ist dadurch bereits reduziert, dass ab 2006 eine weitere Fertigungslinie (200mm-Linie) beim Fraunhofer-Institut in Duisburg von ELMOS betrieben wird. Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch am Standort Dortmund in einem separaten Gebäude eine weitere Produktionslinie errichtet. Damit verfügt ELMOS über mehrere unabhängige Fertigungslinien, die autark voneinander produzieren können.

Die üblichen versicherbaren Risiken wie Feuer, Feuerbetriebsunterbrechung, Wasser, Sturm, Diebstahl, Haftpflicht, insbesondere Produkthaftpflicht, auch in den USA, sowie die Kosten eines etwaigen Rückrufs sind angemessen versichert. Weitere Risiken, die die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeinträchtigen oder den Fortbestand des Konzerns gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

4.8 Beteiligungsbereich

Durch die hohe Allokation von finanziellen Mitteln in die Tochtergesellschaften besteht die erhöhte Pflicht, mit entsprechenden Controlling-Instrumenten und kontinuierlichen Soll-Ist-Analysen mögliche finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen bzw. zu minimieren. So sind für alle Tochtergesellschaften Geschäftspläne und Budgets erstellt worden, deren Erreichen sicherstellen wird, dass hieraus keine bestandsgefährdenden Risiken resultieren.

5. Prognosebericht

ELMOS wird sich weiterhin als Nischenanbieter auf kundenspezifischen Anwendungen für die Automobilindustrie fokussieren. Dabei sind die eigene Technologie, das eigene Design und die Produktion in der eigenen Fertigung feste Säulen dieser Strategie. Das erfolgreiche automobiler ASIC-Geschäft soll weiterhin ergänzt werden mit der vermehrten Vermarktung von anwendungsspezifischen mechatronischen Modulen, die ASICs, Sensoren und funktionale Gehäuse, gegebenenfalls noch mit patentierten Technologien vereinen. Weiter sollen anwendungsspezifische Standardprodukte, die in der Regel auf früher entwickelten ASICs basieren und für die eine Nachfrage von mehreren Kunden absehbar ist, das Produktportfolio erweitern. Es ist zudem Ziel der ELMOS-Gruppe, den Umsatzanteil in sich schneller entwickelnden Märkten neben dem automobilen Markt zu erhöhen, um diese als Innovationstreiber nutzen zu können.

Geographisch gesehen strebt ELMOS eine Durchdringung des nordamerikanischen Markts und mittelfristig eine vermehrte Expansion in den asiatischen Markt an.

Für das Jahr 2005 wird allgemein mit einem Nachfragerückgang im weltweiten Halbleitermarkt gerechnet. In der Automobilindustrie wird jedoch von keinen größeren Veränderungen in der weltweiten Nachfrage nach Halbleitern ausgegangen. Die Zulassungszahlen für Neufahrzeuge werden keine Überraschungen bringen und im Wesentlichen an die Vorjahreszahlen anschließen. Aufgrund des kontinuierlich steigenden Elektronikanteils je Fahrzeug wird der Markt für automobiler Halbleiter weiter steigen. Für die automobilen Halbleiterchips wird ein etwa acht- bis neunprozentiges Wachstum bis 2010 erwartet.

Die gut gefüllte Produkt-Pipeline aus den Design-Wins der vergangenen Jahre und der – trotz der im zweiten Halbjahr 2004 gesunkenen Book-to-bill-Rate – zufriedenstellende Auftragseingang für 2005 unterstreichen dies. Mit der größeren Liefermenge ist eine höhere Auslastung der Fertigungskapazitäten in Dortmund verbunden, was zu einer weiteren Verbesserung der Ertragssituation führen wird.

Dortmund, im Februar 2005

Der Vorstand



Knut Hinrichs

Dr. Klaus Weyer

Dr. Peter Thoma

Reinhard Senf